

# 東京大学・大学院工学系研究科・附属システムデザイン研究センター

## 教員公募

### 1. 公募の趣旨

東京大学大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター(以下 d.lab)は半導体集積回路の高度化、かつ皆がその高度な技術を楽しむ民主化を推進しております。特に、デジタルトランスフォーメーションにより持続可能で安心・安全・快適な人間社会を形成するための基本である半導体集積回路の設計を支える人材を育成することを目指した研究と教育を行っています。この目的を達成するため、より良い未来社会の創出に多大な貢献をしつつ、指導的役割を果たす人材を募集します。特に、集積システムの設計検証、AI ハードウェアやハードウェアセキュリティ等今後の安全安心社会の起点となるべき集積システムの設計、回路からパッケージ回路基板までの設計技術の研究、さらに集積システムのエネルギー、情報システム、センシング、ヘルスケア等の応用分野へ融合・展開することに積極的な人材の応募を期待します。

### 2. 職名及び人数

特任准教授（特定有期雇用教職員）1名：集積システム全般（なお、経歴によっては特任講師としての採用もありうる）

### 3. 契約期間

2023年4月1日～2024年3月31日

### 4. 更新の有無

予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮の上、年度単位により更新する場合があります。ただし、更新9回、2033年3月31日までを限度とする。

### 5. 試用期間

採用された日から6月間。

### 6. 就業場所

東京大学本郷キャンパス・浅野地区（東京都文京区本郷 7-3-1 および東京都文京区弥生 2-11-16）

最寄り駅： 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩5分～10分  
東京メトロ南北線 大前駅 徒歩10分

東京メトロ丸の内線 本郷三丁目駅 徒歩 15分～25分

#### 7. 所属

東京大学大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター基盤設計研究部門  
※業務の都合により変更することがある。

#### 8. 業務内容

- (1) d.lab のミッションとしての半導体集積回路設計の民主化に対する取り組み
- (2) 各分野における独創的かつ革新的な研究の遂行
- (3) 東京大学の学部前期・後期課程及び大学院修士・博士課程の教育
- (4) 組織運営等に関する業務

#### 9. 就業日・就業時間

専門業務型裁量労働制により、1日7時間 45分・週5日勤務したものとみなされる。

#### 10. 休日

土日、祝日法に基づく休日、12月29日～1月3日は休日。

#### 11. 休暇

- ① 年次有給休暇 就業規則に基づき付与
- ② 特別休暇 就業規則に基づき付与

#### 12. 賃金等

年俸制を適用し、業績・成果手当を含め、月額55万円～90万円の範囲で、資格、経験等に応じて決定。

通勤手当（当方で定める支給要件を満たした場合は、当方規定により算定した額を支給、最高55,000円/月）

退職手当、賞与は無し。

原則毎月17日支給。

#### 13. 加入保険

文部科学省共済組合、雇用保険に加入。

#### 14. 災害補償

労働上の災害や通勤時の災害については、労働者災害補償保険法および東京大学教職員法定外災害補償規程により補償。

## 15. 応募資格

- (1) 博士の学位取得又は着任までに取得見込みの者。
- (2) 半導体集積回路設計の民主化に関連する研究・教育に情熱を持って取り組む意欲を持ち、上記の職務を遂行できること。
- (3) 「1.公募の趣旨」で記した分野において卓越した能力と実績を有すること。
- (4) 下に例示する内容の講義および研究指導を日本語もしくは英語で担当できること。  
(担当する講義内容の例；担当内容は協議のうえ決定)  
デジタル回路，電気回路，電子回路，集積回路工学，VLSI 工学，ハードウェア設計論，VLSI アーキテクチャ

## 16. 応募書類

- (1) 履歴書
  - \* 東京大学統一様式を使用すること。  
[http://www.u-tokyo.ac.jp/per01/r01\\_j.html](http://www.u-tokyo.ac.jp/per01/r01_j.html) 参照
  - \* 確実に連絡の取れる電子メールアドレスを明記すること。
- (2) 業績リスト（論文リスト：主要論文 3 編以内に丸印を付ける，学会講演リスト：国際会議と国内会議に分け，招待講演があれば明記）
- (3) 教育実績，社会的活動(学会活動)，知的財産，外部資金獲得実績、受賞などのリスト
- (4) これまでの研究内容 (A4 判 3 ページ以内)
- (5) 今後の研究計画 (A4 判 2 ページ以内)
- (6) 半導体集積回路設計の民主化に関連する研究・教育に関する抱負 (A4 判 1 ページ以内)
- (7) 応募者の業績について照会できる方 3 名の氏名と連絡先

## 17. 応募方法

下記の web サイトに必要事項を記入し，必要なファイルをアップロードすること。  
<https://forms.gle/XKEhbUDunsUnB5rH7>

## 18. 応募締切

2022 年 10 月 28 日 (金)  
書類選考の後，面接試験受験の可否を連絡します。

## 19. 問い合わせ先

東京大学・大学院工学系研究科・システムデザイン研究センター・センター長  
Email: [secretary@dlab.t.u-tokyo.ac.jp](mailto:secretary@dlab.t.u-tokyo.ac.jp)

## 20. 募集者名称

国立大学法人東京大学

## 21. 受動喫煙防止措置の状況

敷地内禁煙（屋外に喫煙場所あり）

## 22. 留意事項

採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性がある。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要がある。

## 23. その他

応募書類は本応募の用途に限り使用し、個人情報とは正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。

応募書類の返却はいたしません。当方で責任を持って廃棄します。

勤務条件の詳細は、東京大学特定有期雇用教職員就業規則等をご覧ください。

（ [http://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki\\_int/kisoku\\_mokuji\\_j.html](http://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/kisoku_mokuji_j.html) ）

東京大学は男女共同参画を推進しており、女性の積極的な応募を歓迎します。

以上